最新・最先端の電子回路テクノロジーが集結する専門技術展

非常に目的意識の高いエンジニア・技術者層、設計開発担当者、生産現場責任者、調達・経営者層が中核来場者です。

■ 電子回路業界全員参加型イベントです。
■ 電子回路製造・開発・研究に関わるすべての製品・技術サービスを網羅した総合展示会です。
■ 国内外のユーザ・バイヤが新製品の購入・新技術の導入を目的にご来場されます。
■ 業界における自社（製品・技術）の認知度・知名度・信頼性の向上に大きく貢献します。
■ 新製品・新技術の発表やマーケティング活動の場としても効果を発揮します。
■ 出展者同士の提携・商取引や情報交換の場としても最適な電子回路・実装総合専門技術展示会です。

多彩な技術、開発トレンド、教育、アプリケーションテーマを取り上げたセミナープログラム

200を超えるプログラムを実施、約10,000人の聴講者を集めています。

■ **ものつくりフェスタ＜基調講演・半導体オブ・ザ・イヤー・電子機器分解特別展示＞**
業界を牽引するトップ企業、次世代企業のキーパーソンによる技術・業界展望、次世代研究発表

■ **第1回プリンテッドエレクトロニクスコンベンション（PEC JAPAN 2012）**
全世界が注目するプリンテッドエレクトロニクスの最新技術動向を専門分野担当者に詳細に解説頂きます。

■ **最先端実装技術シンポジウム**
エレクトロニクス実装学会主催による聴講者・講演者対話重視型の実装技術深堀シンポジウム。※ご出展者へはご来場誘致に最適な無料招待券を配付

■ **中国・台湾・韓国インダストリ・カンファレンス及びパビリオン展示**
海外マーケットの動向、市場開拓に最適となる生の情報を各団体より提供。

■ **出展者製品・技術セミナー（NPIプレゼンテーション・PROTECセミナー）**
出展者は無料にて発表参加いただける出展者による来場者のための情報発信セミナー。

■ **アカデミックプラザ**
マイクロエレクトロニクスショーに併設する大学・研究機関の産学連携を強化イベント。

■ **特別展示・オープンセミナー**
あらゆる層のご来場者に見学・聴講いただける会場内参加無料オープンイベント。

■ **その他、新規来場者に多数ご参加頂ける多彩な併催企画をご提供いたします。**

出展対象品目

JPCA Show 2012

■ プリント配線板技術展 PWB Tech 2012 2012プリント配線板技術展

プリント配線板、設計プロセス技術、配線板用材料、製造プロセス技術・資機材、物流・環境対応システム、関連書籍等

■ 半導体パッケージング・部品内蔵技術展 Module JAPAN 2012 2012半導体パッケージ・部品内蔵技術展

モジュール基板、モジュール実装、設計、モジュール基板・実装材料、製造プロセス技術・資機材、物流・環境対応システム、関連書籍等

■ 機器・半導体受託生産システム展 EMS JAPAN 2012 2012機器・半導体受託生産システム展

プリント配線板実装基板、モジュール実装基板、各種集積回路製造・実装・組立・検査受託サービス

ラージエレクトロニクスショー2012

■ プリンテッドエレクトロニクス最適生産システム展 PE PROCESS 2012 PE最適生産システム展

プリンテッドエレクトロニクス基板、設計・分析システム、高機能材料、印刷・コーティング装置/システム、搬送システム、硬化・乾燥・封止技術、プリンテッドエレクトロニクス応用製品、関連書籍等

■ LED/OLED応用技術展 SS Lighting 2012

LED/OLED（有機EL）及び応用製品（照明、エネルギー、ディスプレイ、タッチパネル他）、LED/OLEDパッケージ材料・素材、設計・分析システム、検査・評価測定技術、LED/OLED製造装置／システム、関連副資材、関連書籍等

■ 部品・MEMS/デバイス産業総合資機材展 Device Engineering 2012

電子部品、MEMS、各種デバイス、設計・分析システム、各種ナノレベル材料・素材、微細加工装置／システム、検査・評価計測技術、各種ナノ技術応用製品、関連書籍等

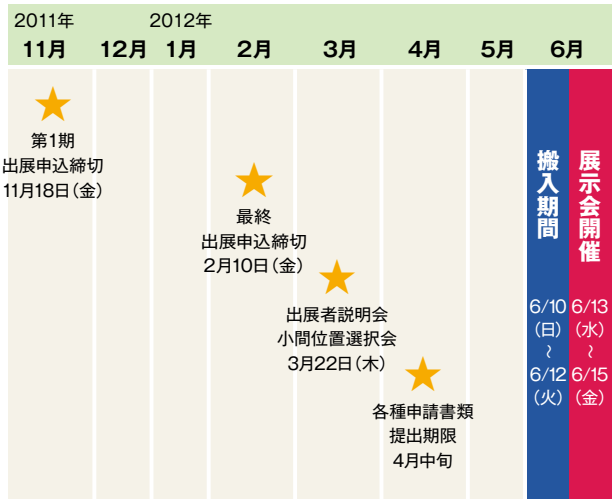
2012マイクロエレクトロニクスショー

最先端将来技術を中心とした、高密度・高周波実装技術応用製品、高密度サブストレート・インターポーザ、部品内蔵基板、半導体チップ、システムインパッケージ（SiP）/ システムオンチップ（SoC）、表示・光デバイス/ センサ、高密度実装関連材料、各種ペースト、鉛フリーはんだ/ 接合材料、封止樹脂・接着剤・アンダーフィル材料、熱対策材料・素材、高周波対応ポリマー、各種ボンダ（ワイヤーボンダ、ダイボンダ、LCD/COG ボンダ等）・ディスペンサ・フリップチップ（FC）実装・BGA/CSP 組立・TAB 実装・OLB/ILB システム・COB システム等各種高密度実装関連システム・装置、生産設備、関連書籍等

JISSO PROTEC 2012

すべての分野での電子部品実装機及び関連機器・システム（電子部品装着機、電子部品挿入機、クリームはんだ印刷機、はんだ付け装置（ディップ槽、リフローオーブン）、ディスペンサ、実装関連機器・システム（搬送システム、テーピングマシーン・材料、バルクフィーダ、その他フィーダ、自動組立装置）、半導体実装機・システム（ワイヤーボンダ、ダイボンダー、フリップチップ実装システム、LCD/COG ボンディングシステム、BGA/ILB システム、COB システム）、検査・試験装置（基板外観検査装置、半導体製造関連検査・測定装置、その他実装関連検査・測定装置）、実装設計システム（設計ツール、生産最適化ソフトウェア、実装プログラミング装置）、実装デバイス・部品及び関連材料（SMD、半導体パッケージ部品、小型電子部品、チップ部品、コネクタ・ソケット、スイッチ、バルク供給部品）、実装デバイス包装材（テーピングリール、キャリアテープ、TAB テープ/ リール、マガジンスティック、IC トレイ、バルクケース）、実装接合システム（はんだ付け装置、はんだ/ 接合材料、アンダーフィル材料）、高周波対応装置・部品・材料、環境関連装置・材料（ゼロミッションプロセス、廃棄物処理・回収に関する装置・材料）、関連書籍等

■スケジュール



■東京ビッグサイトへのアクセス

●お申し込み／お問い合わせ

JPCA 社団法人日本電子回路工業会

〒167-0042　東京都杉並区西荻北3-12-2　回路会館2F
TEL: 03-5310-2020　FAX: 03-5310-2021　担当: 宍戸・樋口（show@jpca.org）